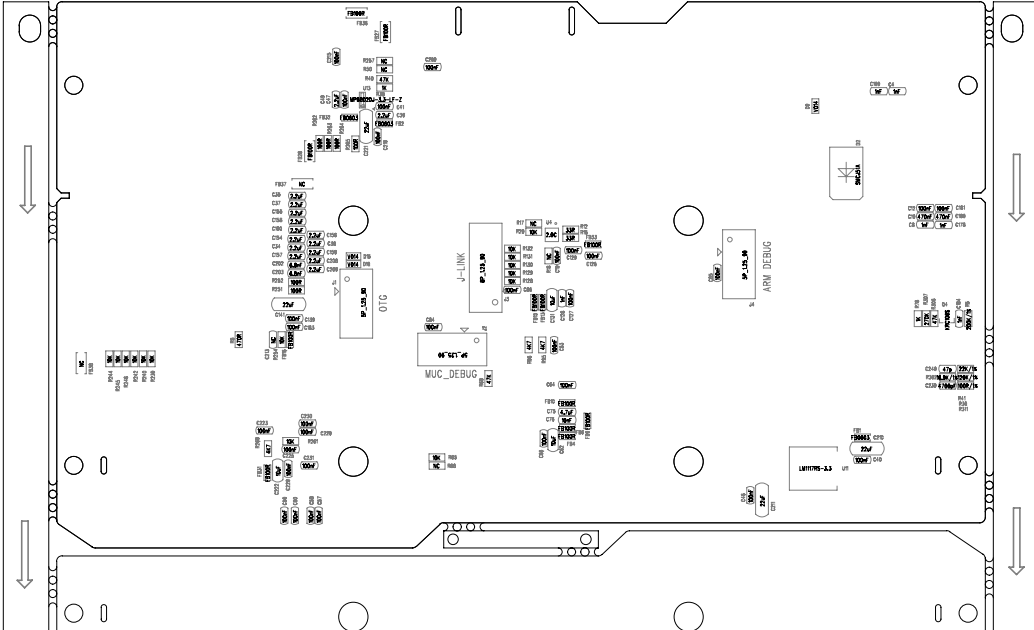
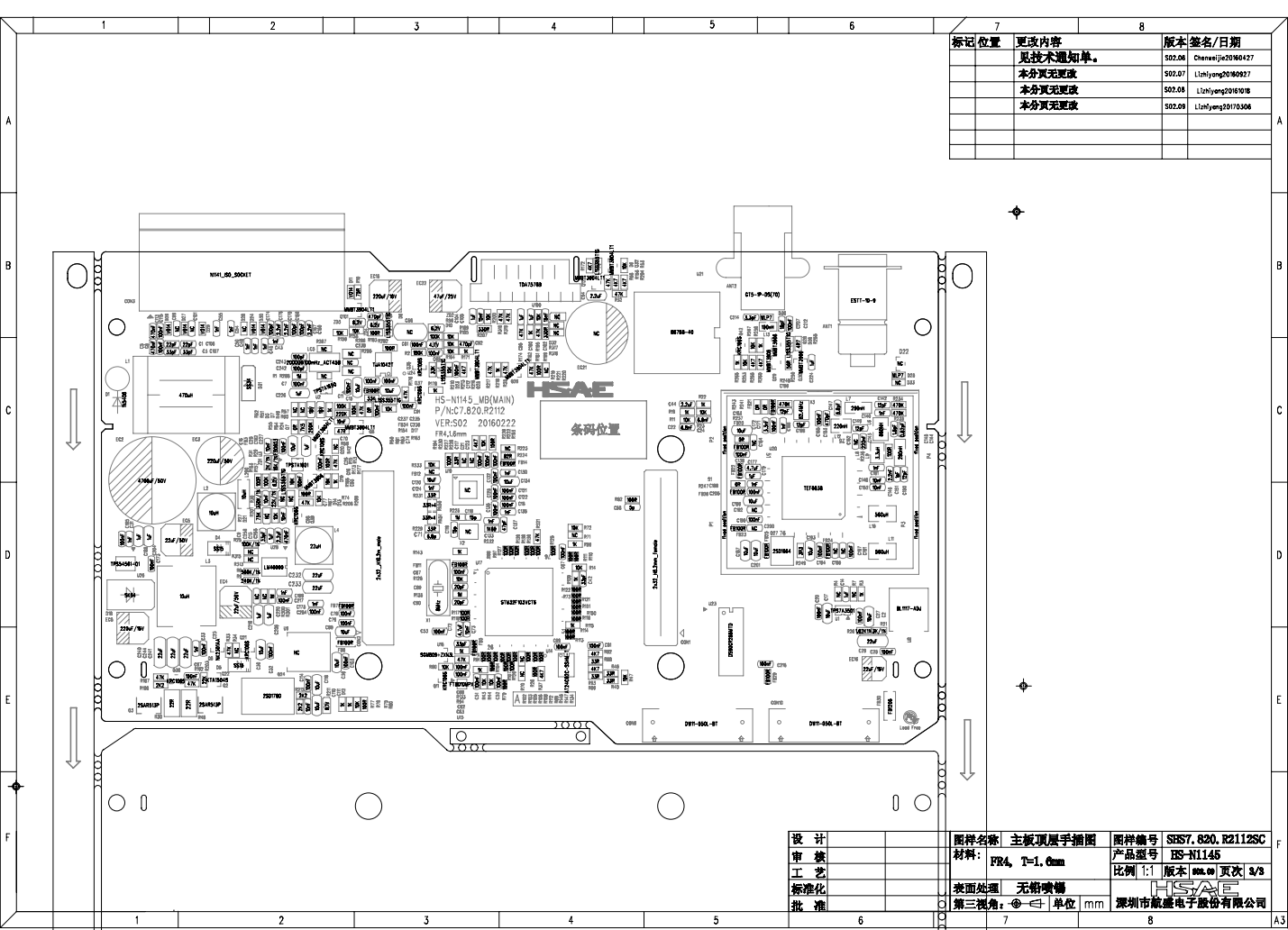


标记	位置	更改内容	版本	签名/日期
		见技术通知单。	S02.06	Chenwei1420160427
		见技术通知单。	S02.07	Lizhiyang20160927
		见技术通知单。	S02.08	Lizhiyang20161018
		见技术通知单。	S02.09	Lizhiyang20170306



设计		图样名称	主板底层贴片图	图样编号	SHS7.820.R2112TP
审核		材料:	FR4, T=1.6mm	产品型号	HS-N1145
工艺		表面处理	无铅喷锡	比例	1:1
标准化		第三视角:	单位 mm	版本	S02.09
批准				页次	2/3
					深圳市康盛电子股份有限公司



标记	位置	更改内容	版本	签名/日期
		见技术通知单。	S02.06	Chenwj@20160127
		本分頁无更改	S02.07	Lizhiyang20160927
		本分頁无更改	S02.08	Lizhiyang20161018
		本分頁无更改	S02.09	Lizhiyang20170306

设计		图样名称	主板顶层手描图	图样编号	SSS7.620.R2112SC
审核		材料:	FR4, T=1.6mm	产品型号	BS-N1145
工艺		表面处理	无铅喷锡	比例	1:1 版本 000.00 页次 3/3
标准化		第三视角:	单位 mm		
批准					

